

御 得 意 様 各位

JPCA Show 2019 (2019 プリント配線板技術展)出展のご案内

拝啓

時下益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。また、平素は格別のご高配を賜り、厚く御礼申し上げます。
さて弊社はこのたび「2019 プリント配線板技術展」において実績豊富なプリント配線板・パッケージングプロセス用の表面処理技術を多数出展いたします。

是非ご来場賜り、弊社出展品をご高覧頂きたくご案内申し上げます。

敬具

記

日 時：2019年6月5日(水)~6月7日(金)

開場時間：10：00~17：00 *最終日は16：00まで

【展示品】

- | | |
|--|---|
| <input type="checkbox"/> パターンビアフィル用硫酸銅めっき添加剤 | <input type="checkbox"/> Fan-Out パッケージングプロセス製品 -LtF プロセス- |
| <input type="checkbox"/> 微細配線用ドライフィルムレジスト剥離剤 | <input type="checkbox"/> メルプレート UBM プロセス |
| <input type="checkbox"/> 微細配線用銅シードエッチング液 | <input type="checkbox"/> DFR 現像・剥離槽 洗浄剤 |
| <input type="checkbox"/> 微細配線用酸性脱脂剤 | <input type="checkbox"/> 多段電解式殺菌装置 |
| <input type="checkbox"/> MSAP 対応薬品 | |

【出展者 (NPI) プレゼンテーション】 *聴講無料

【講演題目】：ドライフィルムレジストはく離剤の開発動向

【講演内容】：当社のドライフィルムレジストはく離に関する開発動向および環境対応についてご説明いたします。

【講演者】：技術開発部 PWB 応用技術開発グループ 主任 服部 奈々

【日 時】：2019年6月6日(木) 11：30~12：00

【場 所】：<西展示ホール内 2F 西 2 商談 6> NPI 会場 B *直接、会場にお越しください

【弊社ブース】

東京ビッグサイト 西展示棟 4階 西3ホール・3-157

